



【プレスリリース】

2020年4月30日

報道関係各位

*本プレスリリースは、[独 congatec AG が、2020年3月23日（現地時間）、ドイツで発表したプレスリリースの抄訳です。](#)

SGET、組込みビジョン、エッジ向けに 高度な接続性を実現する新規格 SMARC 2.1 を採択



SMARC 2.0	SMARC 2.1
2x Serial Ethernet	4x Serial Ethernet
2x PCIe	2x PCIe
2x SPI (0)	4x SPI (0)
MEM = 2x DDR	MEM = 2x DDR
2x LVDS+eDP+MIPI (0)	2x LVDS+eDP+MIPI (0)
DP++(HDMI) + DP++	DP++(HDMI) + DP++
1x SATA	1x SATA
6x USB 2.0 + 2x USB 3.0	6x USB 2.0 + 2x USB 3.0
12x GPIO + 1x SDIO	16x GPIO + 1x SDIO
6x I2C + 2x CAN	6x I2C + 2x CAN
mPA	4x mPA
SPI + I2C	SPI + I2C
Power	Power

高性能組込みコンピューティング製品のリーディングサプライヤーである [congatec（コンガテック）](#) は、組込みコンピューティングに関する技術推進、標準化団体である [SGET（Standardization Group For Embedded Technologies）](#) が新規格 SMARC 2.1 を承認したことを発表しました。同規格の策定にあたっては、スペックエディタのクリスチャン・エダー（Christian Eder）をはじめ、コンガテックが重要な役割を果たしました。新バージョンでは、エッジ接続を拡充する SerDes をサポートし、組込みコンピューティングと組込みビジョンの両立を切望するニーズの高まりに対応して最大 4 つの MIPI-CSI カメラインタフェースを搭載するなど、様々な機能が追加されています。これらの新機能は Rev. 2.0 と後方互換性があり、2.1 モジュールを 2.0 キャリアボードに搭載することが可能です。Rev. 2.0 の拡張機能も選択可能で、コンガテックの SMARC 2.0 モジュールはすべて自動的に SMARC 2.1 との互換性が確保されます。

コンガテックのマーケティング担当ディレクターで、SGET では SMARC 2.1 のスペックエディタを務めた クリスチャン・エダーは次のように述べています。「新しい SMARC 2.1 規格は、スマートフォンに広く使われるカメラテクノロジー-MIPI-CSI を、組込みコンピューティング標準規格に初めてしっかりと規定した重要な一歩となります。あらゆる組込みアプリケーションとの統合を実現するためには、この極めてコスト効率の良いテクノロジーが必要となります。このため、SMARC 2.1 では包括的な状況認識（situation awareness）とデバイス効率を最大化するインタフェースを 1 つまたは 2 つから最大 4 つに増やしています」

[Industry Research 社の最新の調査](#)では、マシンビジョンカメラの需要は堅調な 2 桁成長が続くと予測され、特に、監視、法医学、ロボット手術、高度交通システム、入出国管理、ヘルスマニタリングなど工業用途以外の分野での成長が顕著です。また、工業領域では、充填レベルの異常、生産ラインの不良品、包装不良などのエラーを防止する工程検査にもカメラテクノロジーが活用されています。物流向け自動運転ロボットも産業部門では大きな市場です。

エッジでの接続を拡大するためイーサネットのフル対応が求められる中、PCIe レーン 4 つのうち 2 つは SerDes 信号を介した 2 つの追加のイーサネットポートで提供されます。ここに GigE ビジョンカメラを接続し、映像用に利用することもできます。

その他新たな機能として、使用していない PCIe レーンをオフにして省電力化できる PCIe クロック要求信号や、GPIO（汎用 IO）を 12 ポートから 14 ポートに増加した点などがあります。また、多くの要望に応え、規格ドキュメントも読みやすく再編されました。

##

【関連リソース】

新規格 SMARC 2.1 について詳しくは SGET のウェブサイトをご覧ください（英文）

<https://sget.org/standards/smarc/>

また、コンガテックが作成した SMARC 規格のメリットに関する最新のホワイトペーパー(日本語)はこちらよりダウンロード頂けます

<https://www.congatec.com/jp/technologies/smarc/smarc-21-whitepaper.html>

ARM ベースの NXP i.MX 8 プロセッサを搭載した SMARC 2.1 対応 conga-SMX8 についてはこちらをご覧ください

<https://www.congatec.com/jp/products/smarc/conga-smx8.html>

Intel Atom®プロセッサ（開発コード：Apollo Lake）搭載の SMARC 2.1 対応 conga-SA5 についてはこちらをご覧ください

<https://www.congatec.com/jp/products/smarc/conga-sa5.html>

* Intel ならびに Intel Atom は米国及びその他の国における同社の登録商標です。

タイトル画像（SMARC 2.0 と 2.1 の比較）の高精細画像（264KB）はこちらよりダウンロード頂けます。

<https://www.congatec.com/jp/congatec/press-releases/article/sget-adopts-smarc-21-specification.html>

コンガテックについて congatec AG はドイツのデッゲンドルフに本社を置く Qseven、COM Express、SMARC、SBC の産業用コンピュータモジュールの専門メーカーです。コンガテックの製品は、産業用オートメーション、医療、アミューズメント、輸送、通信、計測機器や POS などの様々な用途に対応できます。コアな知識や技術ノウハウは、ドライバーや BSP のみならずユニークな BIOS 機能も含まれています。デザイン・インの段階以降も、製品のライフサイクル・マネジメントを通してサポートします。弊社の製品は、長期間の提供・保守サービスおよび産業用の品質基準を満たしています。現在、コンガテックは日本、韓国、台湾、米国、オーストラリア、チェコ共和国と中国に販売拠点があります。詳しくは、www.congatec.jp をご参照ください。

* * *

■ 本製品に関するお問合せ先

コンガテック ジャパン株式会社 担当：奥村

TEL: 03-6435-9250 Email: sales-jp@congatec.com

■ **本リリースに関する報道関係者様からのお問合せ先**

コンガテック ジャパン株式会社 (同上)

または (広報代理) プラップジャパン 高橋、谷本

Email: congatec@prap.co.jp